18인치 웨이퍼 양산 2년 앞당겨

TSMC, ASML 지분 인수로 기술개발 투자 ... 인텔도 지분투자

세계 최대의 반도체 수탁 생산기업인 타이완 TSMC가 반도체 칩 장비기업인 네덜란드 ASML의 지분 5%를 인수한다.

TSMC는 ASML 지분 인수에 310억T달러(약 1조2000억원)를 투자할 계획이라고 중국시보가 8월6일 보도했다.

또 앞으로 5년 동안 ASML의 반도체 미세가공 기술개발에 100억T달러(약 3800억원)를 지원할 계획이다.

ASML은 반도체 칩 장비분야 세계 1위로, 차세대 18인치 웨이퍼(반도체의 재료가 되는 얇은 원판) 생산용 장비 개발에 주력하고 있으며, 신규장비 개발 프로젝트에는 미국 인텔(Intel)도 지분투자 형태로 동참했다.

TSMC는 신규장비를 활용해 2015년부터 18인치 웨이퍼를 본격 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

반도체 시장은 ASML, 인텔, TSMC 3사의 협력으로 18인치 웨이퍼 양산이 2년 가량 앞당겨질 것으로 전망하고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2012/08/06>